**國家中山科學研究院材料暨光電研究所**

**108年度第十五次專案人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

需求全時工作人員研發類32員、技術生產類12員、行政管理類1員，共計45員，依「國家中山科學研究院材料暨光電研究所108年度第十五次專案人力進用員額需求表」辦理（如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依本院**新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。**

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)得依條件申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(持國外學歷者須符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格)。

 (一)研發類：

1.碩士(含)以上畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

3.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

 (二)技術生產類：

1.高中(含)以上畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核 薪。

(三)行政管理類：

1.大學畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用三個月內，本院始查覺者，得取消錄取資格︰

(一) 履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。

(二)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(三)無行為能力或限制行為能力者。

(四)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。但情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。但情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(七)因案被通緝或在羈押、管收中。

(八)依法停止任用者。

(九)褫奪公權尚未復權者。

(十)受監護宣告尚未撤銷者。

(十一)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十三)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之懲罰者。

**肆、報名時間及方式：**

一、甄試簡章及職缺需求刊登於本院全球資訊網 (http://www.ncsist.org.tw)，公告報名至108年12月11日止。

二、 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw)填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷，各項資料並依序彙整在同一檔案(PDF檔)上傳。

三、需求單位於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後

 ，辦理初步選員(資格審查)。

四、報考人員經初步選員 (資格審查)合格者，需求單位以電子郵件或簡訊或Line (擇一)通知參加甄試。

五、不接受紙本及現場報名甄試。

六、應屆畢業生報名甄試時尚未取得畢業證書者，僅需繳交學生證掃描檔查驗。前述人員錄取後，需於本院寄發錄取通知日起至報到日期間，繳驗畢業證書正本(如為學校因素無法如期繳交，須出具學校開立之佐證證明)，若無法繳驗，則取消錄取資格。

七、歡迎具身心障礙身分或原住民族身分，且符合報考資格者報名參加甄試，並於人才資料庫登錄資料時註記。

八、為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件4)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：**報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。**各項資料依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳。 報考職缺每人最多以三個為原則。**

一、履歷表(如附件2），並依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院則予不經預告終止契約解除聘雇。

二、主管核章之各類聘僱員工參加招考報名申請表掃描檔(如附件3，僅本院同仁需繳交)。

三、符合報考學歷之畢業證書掃描檔。

四、報考所需之個人掃描檔資料(如：工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等，請參考簡章之員額需求表)。

五、提供工作經歷證明者，格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。

六、若有繳交非我國政府機構之工作經歷證明，需再檢附個人社會保險投保證明(如：勞保、公保、農保…等)，如未檢附，該工作經歷不予認可。

七、具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。

八、具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

一、甄試日期及時間：暫定108年 12月 (實際甄試時間以甄試通知為準)。

二、甄試地點：暫定桃園市龍潭區中科院新新或龍門院區(實際甄試地點以甄試通知單為準)。

三、甄試方式：

(一)研發類：

1.初試：書面審查與口試(配分請參考員額需求表)。

2.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

(二)技術生產類：

1.初試：實作/筆試與口試(配分請參考員額需求表)。

2.項次20、21筆試參考書籍請參照員額需求表甄試方式。

3.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

(三)行政管理類：

1.初試：實作與口試(配分請參考員額需求表)。

2.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

1. 各項甄試作業如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理的調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
2. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件或簡訊或Line通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號、手機號碼及Line。若以電子郵件、簡訊、Line通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
3. 研發類書面審查不合格者及技術生產類書面審查或筆試/實作不合格者，皆不通知參加口試。
4. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

一、單項(書面審查/實作或筆試/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。

二、初、複試(口試)合格標準為70分(滿分100分)。

三、總成績合格標準為70分(滿分100分)。

四、如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。

五、成績排序：

 (一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類、技術生產類、行政管理類：總成績為複試(口試)平均成績。

 (二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由需求單位決定錄取順序。

2.技術生產類：依序以實作平均成績/筆試成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由單位決定錄取順序。

3.行政管理類：依序以實作平均成績/筆試成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由單位決定錄取順序。

六、備取人數：

(一)完成各階段甄試後合格但未錄取之應徵者得設為備取人員，並由單位依成績排定備取順序，依序備取，儲備期限自甄試結果奉院長核定次日起4個月內有效。

(二)人員錄取或遞補來院報到後，其他於本院應徵職缺之錄取或遞補皆視同自動放棄。

**捌、錄取通知：**

一、甄試結果預由本院於甄試後1個月內寄發通知單(或以電子郵件通知)，各職缺錄取情形不予公告。

二、人員進用：錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

總機：(03)4712201或(02)26739638

聯絡人及分機：材料暨光電研究所 林正裕組長357010

 黃瑞婷小姐357231

 劉佳珊小姐357268

 line@帳號：@hwi9801m

(相關甄試期程亦會line上通知，請加入line以利聯繫。)

附件1

| 國家中山科學研究院材電所108年第15次專案人力進用員額需求表 |
| --- |
| 項次 | 需求單位 | 職類 | 學歷需求 | 薪資範圍 | 專長(技能) | 學歷、經歷條件 | 工作內容 | 需求員額 | 工作地點 | 甄試方式 |
|  | 材電所 | 研發類 | 博士畢業 | 77,250|85,000 | 機械 | 1.機械/動力機械/應用力學/光機電/航空/造船/等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3. 具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)熟Solidworks與ANSYS等2D/3D軟體操作者為佳。(2)具備熱傳/結構/機械之設計與分析等專長為佳。(3)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)博、碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.結構熱傳之設計與分析。2.機械系統或機械模組之設計開發。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 博士畢業 | 77,250|85,000 | 材料 | 1.材料/機械/航空等相關理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)超合金真空熔煉鑄造相關研發或製造。(2)超合金方向性凝固鑄造相關研發或製造。(3)金屬粉末氣體霧化製程模擬分析及相關製造技術開發。(4)金屬積層製造技術相關研發或製造。(5)絕熱塗層材料及製程技術開發。(6)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.超合金真空熔煉鑄造技術開發。2.超合金方向性凝固鑄造製程技術開發。3.金屬粉末氣體霧化製程模擬分析及製造技術開發。4.金屬積層製造技術及製程開發。5.絕熱塗層材料及製程技術開發。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩 士畢業 | 56,650|65,000 | 材料 | 1.材料/機械/航空/自動控制/造船等相關理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)鈦合金真空熔煉鑄造相關研發或製造。(2)真空熔煉鑄造相關研發或製造。(3)金屬粉末相關製造技術開發。(4)金屬積層製造技術相關研發或製造。(5)其他與工作內容所列項目相關經驗。3.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.鈦合金真空熔煉鑄造製程技術開發。2.真空熔煉鑄造技術及製程開發。3.金屬粉末製程技術開發。4.金屬積層製造技術及製程開發。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械/動機/應用力學/結構造船/輪機/船舶/海洋工程/水利/航空/航太/工程科學/土木/機電等理工相關系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照者為佳(請檢附證明文件)：(1)曾執行複材結構設計、分析與製作開發等工作經驗。(2)具機械/結構設計、振動與動態分析與量測工作經驗。(3)具聲學或水下聲學分析與量測工作經驗。(4)具各式模治具設計開發工作經驗。(5)具力學模擬分析、Solidworks或 Catia設計軟體工作經驗。(6)具機械類加工製造、檢驗與品管工作經驗。(7)具大數據相關工作經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。(3)國家考試資格、技術士技能檢定等證照。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.複合材料結構設計、結構分析、開發與測試。2.複合材料製程開發研究。 | 5員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 面議 | 電子/電機/資訊/機電整合 | 1.電子/電機/資(通)訊/控制/電信/生醫/光電/動力機械/機電/精密等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)影像偵測追蹤法則、程式開發。(2)影像處理模擬及程式開發驗證。(3)DSP/微處理器嵌入式軟體開發與測試。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.影像處理演算法開發、電路開發與FPGA/DSP程式驗證（具影片中物體偵測、追蹤法則及程式開發經驗為佳）2.DSP韌體程式、應用電路開發，以及電路布局工作。3.FPGA Verilog或VHDL程式開發。2.DSP嵌入式軟體開發與測試（熟TI DSP為佳）。3.C與Matlab軟體開發（具程式優化經驗者為佳）。4.系統流程及程式撰寫。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 面議 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資(通)訊/控制/電信/生醫/光電/動力機械/機電/精密等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)微處理器/DSP應用電路開發與測試。(2)數位電路設計與測試。(3)光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.微處理器/DSP應用電路開發與測試。2.數位電路設計與測試。3.光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。4.視訊訊號介面轉換設計。5.數位控制設計與測試。6.伺服硬體控制電路設計。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機/光電/物理 | 1.光電/物理/天文/太空/電子/電機/生醫等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：(1)具光電元件與系統組、調、測等流程規劃及執行等相關工作經驗。(2)具光電系統設計、性能評估分析、光電系統測試架構設計、光電參數量測與分析等相關工作經驗。(3)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩、博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電系統設計、分析、測試之規劃及執行。2.目標、背景等光電特性之模擬、量測與分析。3.光電系統訊雜比、偵測率及誤差分析。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/動力機械/機電控制/航空 | 1.機械/動力機械/航空/輪機/機電/控制/精密等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)自動控制/控制系統之分析與設計。(2)機電整合系統/機械與電機系統的整合應用。(3)數位控制設計與測試。(4)微處理器/DSP軔體程式開發及測試。(5)伺服控制/伺服機構架構、規格、控制器設計。(6)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)博士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.動態軸承機構系統設計。2.伺服控制/伺服機構架構、規格、控制器設計。3.機電系統整合應用。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電機/電子/醫工/資工/通訊/電信工程 | 1.電機/電子/醫工/資工/控制/通訊/電信工程等相關理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：(1)熟悉C、C++、Python、Java、C#(擇一) 軟體開發及測試。(2)系統整合或測試相關經驗。(3)電腦程式設計與開發相關經驗(GUI/UI/UX；SQL資料庫等)。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 從事以下工作領域之一<一>1.系統開發及整合測試。2.系統流程及程式撰寫。<二>1.系統軟體及測試程式開發。2.系統整合設計。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械/動力機械/應用力學/光電/航空/造船/機電/控制/模具/精密工程等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具工作內容工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.光電產品機構設計、機電整合與系統測試，能導入專案開發過程至量產。3.機械動件/鏡頭光機/系統機構設計。 4熟Solidworks等2D/3D軟體、ANSYS結構熱傳分析軟體操作者為佳。5.具備機械/結構設計/流場/熱流/熱傳/應力/靜力/動態分析等專長為佳。 | 1員 | 桃 園龍 潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 光電/物理 | 1.光電/物理系所畢業2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件者為佳(1)具成像光學設計工作經驗。(2)具光學元件檢測及光學模組調校能力。(3)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.成像、雷射光學設計。2.Code V、Zemax、LightTools、軟體操作。3.光路架設與調校。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 光電/物理/材料 | 1.光電/物理/材料等相關系所畢業2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具備以下工作經驗、條件者為佳(1)具備光學薄膜設計能力。(2)具備真空鍍膜製程經驗。(3)具備橢偏儀、單光儀操作等檢測相關經驗。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗。3.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.Macleod軟體操作與光學薄膜設計。2.真空鍍膜製程。3.薄膜量測分析。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/物理/材料/光電/電機 | 1.機械/物理/材料/光電/電機/大氣等相關理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。4.具以下(1)~(3)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)雷射與物質作用與作用機制模擬之經驗。(2)具雷射於大氣傳播之光電物理模擬分析工作經驗。(3)雷射系統架設、設計或模擬之相關經驗。(4)光、機、電系統整合之相關經驗。(5)處理高熱密度廢熱系統之相關經驗。(6)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 從事以下工作領域之一<一>1.開發雷射對材料作用與模擬技術。2.開發雷射在大氣傳播實驗與模擬技術。<二>1.開發與設計雷射系統以及光學檢測系統。 2.光、機、電系統架設、測試與整合。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/動力機械/機電控制/航空/電機 | 1.電子/電機/資訊/控制/資工/機械/物理/材料/光電等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3. 具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明文件)(1)電力電子、電源轉換、高壓脈衝電路。(2)類比電路分析設計、佈線、測試、除錯、SPICE電路模擬。(3)機電系統整合、設計、分析、除錯。(4)電路設計/整合測試經驗。(5)數位控制程式撰寫經驗。(6)平行運算處理/網路傳輸經驗。(7)其他與工作內容所列項目相關經驗等。3.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等掃描檔。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 從事以下工作領域之一<一>1.電力電子、電源轉換、高壓脈衝電路。2.類比電路分析設計、佈線、測試、除錯、SPICE電路模擬。3.機電系統整合、設計、分析、除錯。<二>1.自適應光學電路設計整合測試。 2.波前感測訊號處理技術。3.平行運算處理技術。4.網路控制高壓驅動器。 | 2員 | 桃 園龍 潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電機 | 1.電子/電機/控制/電力 /機電/光電等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3. 具工作內容相關工作技術經驗之一者為佳(請檢附證明資料)。。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.電源管理系統設計開發。2.電力控制管理監控系統設計開發。3.儲能系統設計開發經驗。4.具備自動化程式控制軟體撰寫能力。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 1. **6**
 | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資訊/控制/電信/通訊/光電/物理等相關理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)fully-custom 或cell-based IC design。(2)熟hspice、icfb laker、verilog、design compiler、prime time、astro/ICC、calibre或其他EDA tool。(3)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | ASIC、類比/數位積體電路設計開發與驗測。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機/控制/通訊/電信/資工/資訊/機械/光電/物理等相關理工 | 1. 電子/電機/控制/通訊/電信/資工/資訊/機械/光電/物理等相關理工系所畢業。
2. 具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。
3. 具以下(1)~(3)任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：

(1)具機電真空系統儀具量測與校正經驗(2)具半導體量測儀器操作與維護經驗(3)具程式編碼撰寫能力(如labview、 C語言)1. 檢附以下證明文件供書面審查：

(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表期刊第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 從事以下工作內容至少2項：1. 進行半導體元件真空量測系統操作以及影像訊號校正。
2. 進行熱影像封裝晶片電路測試以及影像測試平台介面開發工作。
3. 可支援一般研發專案管制工作。
 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 1. **1**
 | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電機/伺服控制 /自動控制/光電系統 | 1.電機/機電/光電/控制/物理/機械等理工系所畢業。2.具有全民英檢中級/ /TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)電力電機系統/機電系統的整合應用。(2)自動控制/馬達控制系統之分析與設計。(3)光電系統設計及研製。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗。4.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.系統電力電機系統開發設計規劃與評估。2.系統自動控制/馬達控制系統開發設計規劃與評估。3.光電系統設計與整合。4.須能配合計畫需求加班或至外地出差。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 專案管理/生產管理/系統工程 | 1.電子電機/機械/光電航空/造船/自動控制/工業工程等相關理工系所畢業。2.具有全民英檢中高級/ /TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具第二外國語文為佳。4.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附證明資料)：(1)具專案管理/生產管理/物料管理/工業工程等相關工作經驗者。(2)其他與工作內容所列項目相關經驗。5.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.專案管理執行、專案建案、生產規劃與管制、合約管理等相關管制及系統整合工作。2.資源分配、時程管制、風險管理與流程改善，品質稽核等工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電機/電子/電控/電信  | 1.學、經歷條件：(1)電機/電子/電控/電信/機電/光電/物理等相關理工系畢業。(2)未具上述科系者需從事相關工作經驗1年以上。(需檢附相關工作經歷證明)2.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附相關證明)：(1)系統組裝測試相關經驗。(2)電路測試相關經驗。(3)軟體測試相關經驗。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗。3.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(4)其它有助審查資料之文件。 | 1.系統組裝、測試。2.軟體/電路測試。3.須能配合計畫需求加班或至外地出差。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試50%**電路學(參考書目:電路學第五版，出版社：全華)(70分合格，合格者方可參加口試)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電機/光電/物理/機械 | 1.學、經歷條件：(1)電子/電機/機械/光電/物理等理工科系畢業。(2)未具上述科系者需從事相關工作經驗。(需檢附相關工作經歷證明)2.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)具專案管理2年以上相關工作經驗。(2)熟悉Office Word、Excel、Project、PPT等相關作業軟體。(3)其他與工作內容所列項目相關經驗。3.檢附以下證明文件供書面審查：(1)大學(含)以上各學年成績單。(2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(3)其它有助審查資料之文件。 | 1.執行專案企劃與管制，包括時程、預算、購案及文件管理工作。2.執行相關規劃整備及文案作業。3.須能配合計畫需求加班或至外地出差。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試50%**專案管理(70分合格，合格者方可參加口試)參考書目: 專案管理知識體系指南PMBOK GUIDE第六版，作者：PMI國際專案管理學會)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 電子/電機/光電/機電  | 1.學、經歷條件：(1)電子/電機/電信/電訊/光電/機電/資訊等理工科系(組)畢業。(2)未具上述科系者需從事相關工作經驗。(需檢附相關工作經歷證明)2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。3.具以下工作經驗、條件、證照之一者為佳(請檢附證明資料)：(1)需檢附專科(含)以上各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。(2)1年(含)以上機電整合、光電量測、電路板檢測、接頭佈線等相關工作經驗為佳。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1執行光電模組、系統製作及測試、線路配接、機台操作與維護工作。2.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。3.電路板焊接、組裝及測試。4.電路板布局(熟悉Altium、Allegro、PADS等軟體)及布局系統維護。5.可配合輪班、調班、出差。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****實作50%：**1.電子電路錫焊。2.示波器或電表等儀器操作。(70分合格，合格者方可參加口試)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 1. **1**
 | 材電所 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 機械/材料 | 1.學、經歷條件：(1)機械/模具/造船/航空/海洋工程/水利/工程科學/模具/製造工程/工業工程/工業設計/設計/材料/化學/纖維等相關科系畢業。(2)未具上述科系者需從事相關工作經驗。(需檢附相關工作經歷證明)2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)複材製作與材料機械性質量測。(2)車、銑床、焊接等機械加工。(3)機械製圖、組裝、膠合與檢測。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.複合材料製作及加工。2.機械製圖、組裝、膠合與檢測及機械性質量測。3.機械加工(含鉗工)。4.製程夾模治具設計與製作。5.相關生產支援、物管及備料。6.可配合輪班、調班、出差。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****實作50%：**1.機械視圖2.模型製作(70分合格，合格者方可參加口試)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 化學/材料 | 1.學、經歷條件：(1)化學/材料/纖維/複合材料等相關理工科系畢業。(2)未具上述科系者需從事相關工作經驗。(需檢附相關工作經歷證明)2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。3.具以下工作經驗、條件、證照者為佳(請檢附相關證明)：(1)材料檢測。(2)複材預浸料製作。(3)樹脂調配。 | 1.材料檢測。2.樹脂配方。3.複材預浸料製作。4.複材製作。5.相關生產支援、物管及備料。6.可配合輪班、調班、出差。 | 1員 | 桃園龍潭及新北三峽 | **初試：****實作50%：**模型製作 (70分合格，合格者方可參加口試)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 機械/材料 | 1.學、經歷條件：(1)機械/模具/造船/航空/材料/化學/纖維等相關理工科系畢業。(2)未具上述科系者需從事相關工作經驗。(需檢附相關工作經歷證明)2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：(1)複材製作與材料機械性質量測。(2)車、銑床、磨床、焊接等機械加工。(3)機械製圖、機械/光學組裝、檢測。(4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 從事以下工作內容，並可配合輪班、出差:1.機械製圖、機械/光學組裝、檢測及機械性質量測。2.機械加工(含鉗工)。3.製程夾模治具設計與製作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****實作50%：**1.機械視圖2.機械實作3.組裝實作(70分合格，合格者方可參加下一道實作及口試)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 高中職畢業 | 30,900|37,000 | 光電/機械 | 1.學經歷條件：(1)化工/模具/機械/光電/電子/電機等相關理工科系畢業。(2)未具上述科系者需從事相關工作經驗。(需檢附相關工作經歷證明)2.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。3.具以下工作經驗、條件者為佳:(1)具光學元件製作及檢測工作經驗。(2)具光學元件鍍膜製程工作經驗。(3)具光學鏡頭組裝及調校工作經驗。 | 1.鏡片製作與檢測。2.鏡頭組裝與調校。3.可配合輪班、調班、出差。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****實作50%：**1.機械視圖2.鏡片/光學元件組裝(70分合格，合格者方可參加口試)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
|  | 材電所 | 行政管理類 | 大學畢業 | 33,990|40,000 | 專案管理 | 1.學、經歷條件：1. 理工科系、管理、英(語)文、外語、經濟、財經、會計等相關科系畢業。
2. 未具上述科系者需從事2年以上相關工作經驗。(需檢附相關工作經歷證明)

2.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。3.具2017或2018天下雜誌2000大企業專案管理經驗為佳。4.具Office或企業管理軟體操作與應用能力。5.需檢附各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。 | 1.專管計畫管理、預算管制與會議簡報製作。2.辦理企劃、人事、採購、國際行銷、資訊綜合業務、網路伺服器管理等一般例行性業務及各項業務資料處理。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****實作50%**1.Excel2.powerpoint(70分合格，合格者方可參加口試)**口試50%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 合計：研發類32員、技術類12員、行政管理類1員，合計45員 |

附件2

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 |  | ★身分證號碼 |  | 最近三個月1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | 年月日 | 婚姻 | □已婚 □未婚 |
| ★兵役狀況 | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) |
| ★電子郵件 |  |
| ★通訊處 | 戶籍地址 |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | 連絡電話 |  |
| 居住國外在台聯絡人員(緊急聯絡人) |  | 行動電話 |  | 連絡電話 |  |
| ★學歷 | 學校名稱 | 院系科別 | 學位 | 起迄時間 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 |
| ★經歷 | 服務機關名稱 | 職稱(工作內容) | 起迄時間 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 家庭狀況★ | 稱謂 | 姓名  | 職業 | 服務機關 | 連絡(行動)電話 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** |
| 三親等親屬及朋友在中科院任職之★ | 關係(稱謂) | 姓名  | 單位 | 職稱 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | 體重：　　 　　　公斤 | 血型： 　　　型 |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | 族 別：　　　 　　　　　族 |
| 身心障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 簡要自述(請以1頁說明) |
|  |

(本表若不敷使用請自行延伸)　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修**

一、畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

二、學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

三、學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

四、英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

五、具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

六、相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

七、其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

**履歷表補充附表**

**填表日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | ★**姓名** | 　 |
| **2** | ★**報考職類** | □研發類　 □技術類　 □行政、管理類 |
| **3** | ★**報考項次****(報考至多3個職缺為原則)** |  |
| **4** | **前一份工作月薪** | 元 | **前一份工作年薪** | 元 |
| **5** | ★**預期月薪** | 元 | ★**可接受最低月** | 元 |
| **6** | **語言能力** |  |
| **7** | **專長** |  |
| **8** | **本院產學合作案或其他合作計畫** |
| 8.1 | 計畫名稱 | 　 | 期程 | 至 | 本院合作單位 | 　 |
| **9** | **證照** | **計\_\_\_\_張** |
| **10** | **論著** |
| **10.1** | **碩士論文名稱** |  |
| **10.2** | **博士論文名稱** |  |
| **10.3** | **國內外學術期刊發表論文** | **計\_\_\_\_\_篇** |
| 10.3.1 | 論文名稱 | 　 |
| 發表期刊名稱 | 　 |
| **10.4** | **國內外研討會發表論文** | **計\_\_\_\_\_篇** |
| 10.4.1 | 論文名稱 | 　 |
| 研討會名稱 | 　 |
| **10.5** | **其他著作** | **計\_\_\_\_\_篇** |
| 10.5.1 | 著作名稱 | 　 |

 (本表若不敷使用請自行延伸) 備註：有★為必填欄位

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現職單位（至二級） | 姓名(身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷(含科/系/所) |
|  |  |  |  |
| 擬參加甄選單位職缺 |
| 報考單位(或工作編號) | 職類 | 職缺 |
|  |  |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | 一級單位主管批示 |
| 電話： |  |  |
| 一級人事單位 |
|  |

備註：非本院現職員工免填。